

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

2021年12月10日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决的形式在深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座6楼会议室召开了第五届董事会第十三次会议。本次会议通知已通过邮件方式送达。公司现有董事9名，应出席会议董事9名，实际出席董事9名，其中4名董事为通讯方式出席。会议由公司董事长胡庆周先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于签署〈英唐半导体产业园项目之合作协议〉的议案》

为持续推进向上游半导体行业转型的战略布局，公司拟与中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司签署《中唐空铁产业发展有限公司、深圳市英唐智能控制股份有限公司、深圳市英盟系统科技有限公司关于英唐半导体产业园项目之合作协议》（简称“《英唐半导体产业园项目之合作协议》”），三方规划通过合资设立项目公司四川英唐芯科技有限公司（暂定名，以最终注册登记为准），在成都投资建设“英唐半导体产业园”项目。项目公司注册资本暂定为5亿元，其中公司或合并报表范围内子公司以股权及货币方式合计出资1.25亿元，拟持有项目公司25%的股权。项目公司对外投资项目分三部分投资建设，分别为建设年产1.2-1.8亿颗的光学封测生产线及年产150-200万颗的IPM封测生产线、年产72万片的FAB 6英寸特色(含SiC)工艺线，以及建设年产能20亿

颖的先进封测生产线。

本次通过上海芯石股权和自有资金参与“英唐半导体产业园项目”，将建设器件制造和配套的封测产线，标志着公司产线建设规划全面落地进程的开启，也将为公司未来进一步的规模化生产制造提供重要的基础支撑，增加在半导体产品国产替代加速过程中的竞争优势和发展潜力，促进公司战略目标的早日实现，符合公司和股东的长远利益。本次项目公司设立完成后，公司直接持有上海芯石的股权份额下降至 15%，其不再纳入公司合并报表范围，但公司、项目公司作为上海芯石股东，仍将与其保持全方位合作，不会对公司财务及经营成果产生不利影响。具体内容详见公司 2021 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于签署〈英唐半导体产业园项目之合作协议〉的公告》（公告编号：2021-076）。

该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年12月13日